



Mate 2004 第10回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」

シンポジウム 《ブロードバンドインターネット時代に向けた生産技術革新とサイエンス》参加者募集

- 主 催：**(社) 溶接学会 マイクロ接合研究委員会
エレクトロニクス生産科学会準備会
- 共 催：**(社) 機械学会 エレクトロニクス実装における信頼性設計に関する研究分科会, (社) 高温学会 加工・再生研究情報委員会, (社) 日本塑性加工学会 接合・複合分科会 レーザ加工学会, 技術研究組合 超先端電子技術開発機構 (ASET) 電子SI技術研究部, IMS プロジェクト 環境対応次世代接合技術の開発, 大阪大学 先端科学技術共同研究センター

開催趣旨：

日本のエレクトロニクス産業は、この20年間、高機能化、高信頼化、小型化、低コスト化の技術開発に支えられた新たな電子デバイス・部品を組み込んだ電子システム創成の下、日本の高度成長を牽引してきました。今後も日本が世界を先導し続けるには、生産技術を科学的に探求することはもちろんのこと、既存の学問領域、設計・生産技術などの領域を越えて、エレクトロニクスを取巻く科学技術、経営・生産システム、価値システム、などの広い範囲を取り込んだグローバ

ルなオプティマイゼーションが必要になってきています。本シンポジウムでは、これら生産技術に関する最新の研究・開発に関する研究者相互の情報交換の場をより広くかつ定期的に持ち、生産の科学と技術の進展を促すことを目的として企画開催されます。

日時：平成16年2月5日（木）8:50～17:40

平成16年2月6日（金）9:00～17:30

会場：パシフィコ横浜 会議センター

5階（小ホール，501，502）

横浜市西区みなとみらい1丁目1-1

TEL: 045-221-2121

シンポジウム参加登録費（論文集代を含む）

○主催・共催団体登録会社：20,000円

○溶接学会，協賛学協会会員会社：30,000円

○論文口頭発表者：15,000円

○大学・国公立研究機関：10,000円

○学生：5,000円

○その他（一般）：40,000円

シンポジウム参加申し込み方法

所定の用紙に必要事項（申込者氏名，連絡先住所，電話番号，FAX番号など）を記入し，次の申込先にお申し込み下さい。受付次第，参加受付書を返送させていただきます。参加登録料は，現金書留，郵便振替，銀行振込のいずれかでお支払い下さい。

問合せ，申込先：（社）溶接学会 Mate 2004 事務局
担当連絡先：

TEL：06-6879-8698，FAX：06-6878-3110

E-Mail：mate@jwri.osaka-u.ac.jp

参加申し込み締め切り日：平成16年1月20日（火）

振込先銀行：三井住友銀行 豊中支店

口座番号：普通 No.1962097

口座名義：Mate 組織委員会 渥美 幸一郎

シンポジウム URL：

<http://www.soc.nii.ac.jp/jws/research/micro/Mate2004.html>

プログラム（セッション名と発表件数）

2月5日（木）8:50～17:40（18:00～懇親会）

◆特別講演セッション

「生産技術革新とサイエンス」

○有機ELデバイスの現状と課題

○カーエレクトロニクスにおける生産技術動向

○本質を探る最先端の分析・解析技術

[A-1] フロー槽・鉄系材料の侵食 (4件)

[A-2] 機械的信頼性 (5件)

[A-3] ソルダ材料 (6件)

[B-1] 導電性樹脂接続 (4件)

[B-2] 微細接合 (5件)

[B-3] 接合技術 (6件)

[C-1] 基板 (4件)

[C-2] 基板・配線 (5件)

[C-3] レーザプロセッシング (6件)

2月6日（金）9:00～17:30

[A-4] 評価 (5件)

[A-5] ソルダリング (5件)

[A-6] Sn-Zn系Pbフリーソルダ (4件)

[A-7] Sn-Ag系Pbフリーソルダ (5件)

[B-4] 環境・リサイクル (4件)

[B-5] フリップチップボンディング (6件)

[B-6] パンプ (4件)

[B-7] BGA, CSP (5件)

[C-4] 薄膜・微細プロセス (5件)

[C-5] 開発I (5件)

[C-6] 開発II (5件)

（一般論文発表合計98件）